



Таблица 1

Условное обозначение отб.	Диаметр отб., мм	Диаметр контактной площадки, мм	Наличие металлизации	Кол. отб.
	0,8±0,05	1,6	Да	41
	1±0,05	1,6	Да	24
	12±0,05	2,5	Да	6
	15±0,05	2,6	Да	18
	24 ^{+0,25}	3,0	Да	2
	28 ^{+0,25}	-	Да	4

- Общие допуски формы и расположения - 30893.2-2002 - Н.
- Шаг координатной сетки 0,25мм ГОСТ Р 51040-97
- Плату изготовить комбинированным позитивным методом.
- Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009 - 2.
- Параметры отверстий платы приведены в таблице 1.
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости - 1.
- Финишное покрытие металлизированных поверхностей меди по ГОСТ 9.301-86 толщиной не более 500нмкм флюсом ЛТИ-120 ГОСТ 19250-73 и припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76.
- Контроль функциональный ручным методом по ГОСТ 23752.1-92.
- Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.014-75.

				ИУ4.11.03.03.21.7.314.002				
				УМЗЧ на биполярных транзисторах Плата печатная		Лит	Масса	Масштаб
Изм/Лист	№ док-м	Подп	Дата					2,5:1
Разраб	Круглов В. С.							
Проб	Селиванов К.В.							
Т.контр						Лист	Листов 1	
Н.контр				Стеклоэлектродит ФЧ-2Н-35Г-3,0 ГОСТ 10316-78		МГТУ им. Н.Э.Баумана Кафедра ИУ4 Группа ИУ4-735		
Учб								

Перв. примен.
ИУ4.11.03.03.21.7.314.001

Строч. №

Подп. и дата

Имя № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Имя № подл.